



制作焊盘

因为我们要在 Top 层和 Bottom 层都放置焊盘,所以在制作焊盘的时候就需要制作两种类型的焊盘,一种对应 Top 层,一种对应 Bottom 层.首先来制作 top 层的焊盘,打开 Pad designer,设置参数如下图:

arcanic					
Pads	tack layers				Views
	 Single layer mode 	Type: Single			
	Layer	Regular Pad	Thermal Relief	Anti Pad	
Bgn	BEGIN LAYER	Rect 0.7000 X	Null	Null	A
->	SOLDERMASK_TOP	Rect 0.7000 X	N/A	N/A	
	SOLDERMASK_BOTTOM	Null	N/A	N/A	
	PASTEMASK_TOP	Rect 0.7000 X	N/A	N/A	
	PASTEMASK_BOTTOM	Null	N/A	N/A	
	FILMMASK_TOP	Null	N/A	N/A	
	FILMMASK_BOTTOM	Null	N/A	N/A	+
eome hape: ash: /idth: eight: ffset`	Regular Pad try: Rectangle ▼ 0.7000 3.2000 3.2000 4.00000 4. 0.0000 4. 0.0000		hermal Relief Null 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000		Ani Pad
		Consert lawse	PASTEMA		

将上面的焊盘保存,新建一个焊盘配置参数如下,注意上下两 图的不同.



建立封装

焊盘建立完毕后我们需要建立封装,打开 PCB Editor,新建一个 Package Symbol

New Drawing			×			
Project Directory	pject Directory: C:/SPB_Data/worklib/reusetop/physical					
Drawing <u>N</u> ame:	PCI36	Browse	Cancel			
Drawing <u>T</u> ype:	Package symbol	<u>T</u> emplate	<u>H</u> elp			
	Board Board (wizard) Module					
	Package symbol Package symbol (wizard)					

修改图纸尺寸及栅格点后开始放置焊盘,先放置

top 层焊盘

P1/3





然后放置 Bottom 层焊盘,



查看 3D 视图如下:



添加必须的丝印层、装配层、place bound 以及 RefDes 完成封装

Comtech 优势

- 实力雄厚的资深技术团队,多名 10 年以上经验的 FAE
- 丰富的 PCB 设计/EDA 平台建设等实践经验
- 出色的二次开发能力,为客户提供各种定制化开发需求
- 高效的技术服务平台,通过电话/邮件/Web/BBS,及时帮客 户解决各类软件使用/设计相关问题
- 实战指导、项目现场支持等特色服务
- 最新技术资料下载客户专享通道,包括软件使用技巧、设 计经验、国外技术文献翻译等
- 为客户提供量身定制的全面的针对性培训服务

联系方式

科通数字技术有限公司

总部:深圳市南山区高新南九道微软科通大厦 8-11 层

产品经理: 王其平

手机: 18049720018

邮件: QipingWang@comtech.com.cn

地址:上海市徐汇区桂平路 426 号华鑫商务中心 2 号楼 7 层 03-04 室

华东地区

联系人: 陈敏敏

手机: 18017922811

邮件: PeterChen@comtech.com.cn

地址:上海市徐汇区桂平路 426 号华鑫商务中心 2 号楼 7 层 03-04 室

Comtech 解决方案

- Cadence PCB 设计平台建设
- ECAD/CIS 库平台建设
- Allegro 软件二次开发
- PCB项目设计及仿真外包服务
- Cadence 软件培训服务

P 2 / 3



华南及西部地区

联系人: 谭波涛

- 手机: 15920086575
- 邮件: terrytan@comtech.com.cn
- 地址:深圳市南山区高新南九道微软科通大厦 8-11 层

华北地区

联系人: 党建成

手机: 18010161381

- 邮件: SudyDang@comtech.com.cn
- 地址:北京市海淀区中关村大街1号海龙大厦14层北区1418-21